

Розкриття забезпечує способи зменшення пилу за допомогою обробки насіння композицією, що зменшує пил, описаною тут. Розкриття також забезпечує способи зменшення піддання сівалки з пневматичними висіваючими апаратами дії пилу, що виділяється під час сіву насіння, за допомогою нанесення на насіння композиції, описаної тут. Також забезпечені способи підвищення гладкості насіння за допомогою дражування насіння композицією, описаною тут. Також описані композиції та насіння, придатні для застосування у вказаних способах.